

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-179734

(43)Date of publication of application : 28.06.1994

(51)Int.Cl.

C08F299/02
C08F 2/44
C08L 71/12

(21)Application number : 04-333918

(71)Applicant : ASAHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing : 15.12.1992

(72)Inventor : KATAYOSE TERUO
KUROKI MASAKATSU

(54) CURABLE RESIN COMPOSITION AND CURABLE COMPOSITE MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a new curable polyphenylene ether resin composition, having excellent dielectric characteristics of a polyphenylene ether and capable of manifesting excellent chemical and heat resistance after curing.

CONSTITUTION: This curable resin composition is composed of (a) a reactional product of a polyphenylene ether with an unsaturated carboxylic acid or an anhydride thereof, (b) at least one compound selected from the compound group consisting of diallyl phthalate, divinylbenzene, polyfunctional acryloyl compounds, polyfunctional methacryloyl compounds, polyfunctional maleimides, polyfunctional cyanic acid esters, polyfunctional isocyanates, unsaturated polyesters, epoxy resins, phenolic resins and polybutadiene-based polymers and/or a prepolymer thereof and (c) a thermoplastic resin. Furthermore, this composite material is prepared by impregnating a substrate with this curable resin composition. The composite polymer is laminated and hot cured.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 25.11.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3178925

[Date of registration] 13.04.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-179734

(43)公開日 平成6年(1994)6月28日

(51)Int.Cl. ⁵ C 0 8 F 299/02 2/44 C 0 8 L 71/12	識別記号 M R S M C S L Q P	府内整理番号 7442-4 J 7442-4 J 9167-4 J	F I	技術表示箇所
---	---------------------------------	--	-----	--------

審査請求 未請求 請求項の数 5(全 18 頁)

(21)出願番号 特願平4-333918	(71)出願人 旭化成工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号
(22)出願日 平成4年(1992)12月15日	(72)発明者 片寄 照雄 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株式会社内 (72)発明者 黒木 正勝 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株式会社内

(54)【発明の名称】 硬化性の樹脂組成物および硬化性複合材料

(57)【要約】

【目的】 ポリフェニレンエーテルの優れた誘電特性を有し、硬化後に優れた耐薬品性と耐熱性を示す新規な硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂組成物を提供する。

【構成】 (a) ポリフェニレンエーテルと不飽和カルボン酸または不飽和カルボン酸無水物との反応生成物、および、(b) ジアリルフタレート、ジビニルベンゼン、多官能性アクリロイル化合物、多官能性メタクリロイル化合物、多官能性マレイミド、多官能性シアン酸エステル、多官能性イソシアネート、不飽和ポリエステル、エボキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリブタジエン系ポリマーからなる化合物群から選ばれた少なくとも1つの化合物および/またはそのブレボリマーからなる硬化性樹脂組成物、および(c) 熱可塑性樹脂を基材に含浸させて複合材料を得る。複合材料は積層し、加熱・硬化させる。

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】(a) ポリフェニレンエーテルと不飽和カルボン酸または不飽和カルボン酸無水物との反応生成物、および、(b) ジアリルフタレート、ジビニルベンゼン、多官能性アクリロイル化合物、多官能性メタクリロイル化合物、多官能性マレイミド、多官能性シアン酸エステル、多官能性イソシアネート、不飽和ポリエスチル、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリブタジエン系ポリマーからなる化合物群から選ばれた少なくとも1つの化合物および／またはそのプレポリマー、および(c) 熱可塑性樹脂、からなる硬化性樹脂組成物であって、(a) 成分と(b) 成分の和100重量部を基準として(a) 成分が98～40重量部、(b) 成分が2～60重量部であり、(a)+(b) 成分100重量部に対して、(c) 成分が2～60重量部であることを特徴とする硬化性樹脂組成物。

【請求項2】請求項1記載の硬化性樹脂組成物を硬化して得られた硬化樹脂組成物。

【請求項3】(a) ポリフェニレンエーテルと不飽和カルボン酸または不飽和カルボン酸無水物との反応生成物、(b) ジアリルフタレート、ジビニルベンゼン、多官能性アクリロイル化合物、多官能性メタクリロイル化合物、多官能性マレイミド、多官能性シアン酸エステル、多官能性イソシアネート、不飽和ポリエスチル、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、架橋性ポリブタジエン系ポリマーからなる化合物群から選ばれた少なくとも1つの化合物および／またはそのプレポリマー、および(c) 熱可塑性樹脂、および(d) 基材からなる硬化性複合材料であって、(a) 成分と(b) 成分の和を基準として(a) 成分が98～40重量部、(b) 成分が2～60重量部であり、かつ(a)+(b) 成分100重量部に対して(c) 成分が2～60重量部であり、かつ(a)～(d) 成分の合計100重量部を基準として(a)+(b)+(c) 成分が95～10重量部に対して(d) 成分が5～90重量部であることを特徴とする硬化性複合材料。

【請求項4】請求項3記載の硬化性複合材料を硬化して得られた硬化複合材料。

【請求項5】請求項4記載の硬化複合材料と金属箔からなる積層体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は硬化性樹脂組成物およびこれを硬化して得られる硬化体に関する。さらに本発明は、該樹脂組成物と基材からなる硬化性複合材料、その硬化体、および硬化体と金属箔からなる積層体に関する。本発明の樹脂組成物は、硬化後において優れた耐薬品性、誘電特性、耐熱性を示し、電子産業、宇宙・航空機産業等の分野において誘電材料、絶縁材料、耐熱材料に用いることができる。

10

20

30

30

40

50

【0002】

【従来の技術】近年、通信用、民生用、産業用等の電子機器の分野における実装方法の小型化、高密度化への指向は著しいものがあり、それに伴って材料の面でもより優れた耐熱性、寸法安定性、電気特性が要求されつつある。例えばプリント配線基板としては、従来からフェノール樹脂やエポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂を材料とする銅張り積層板が用いられてきた。これらは各種の性能をバランスよく有するものの、電気特性、特に高周波領域での誘電特性が悪いという欠点を持っている。この問題を解決する新しい材料としてポリフェニレンエーテルが近年注目をあび銅張り積層板への応用が試みられている。

【0003】ポリフェニレンエーテルを利用する方法の一つは、硬化性のポリマーやモノマーを配合して用いる方法である。硬化性のポリマーやモノマーと組み合わせることによってポリフェニレンエーテルの優れた誘電特性を改善し、かつポリフェニレンエーテルの優れた誘電特性を生かした材料を得ることができる。硬化性のポリマーやモノマーとしては、エポキシ樹脂(特開昭58-69046号公報など)、1,2-ボリブタジエン(特開昭59-193929号公報など)、多官能性マレイミド(特開昭56-133355号公報)、多官能性シアン酸エステル(特開昭56-141349号公報など)、多官能性アクリロイルまたはメタクリロイル化合物(特開昭57-149317号公報など)、トリアリルイソシアヌレートおよび／またはトリアリルシアヌレート(特開昭61-218652号公報など)、イソシアネート化合物等、数多くの例が知られている。

【0004】しかしながらポリフェニレンエーテルは、本来耐薬品性をまったく持たないため、たとえ硬化性のポリマーやモノマーを併用してもその改善には自ずと限界があった。これは、ポリフェニレンエーテルを何ら変性を行わずに用いていたためである。また、PPE自体は成膜性を持たないため、フィルムはできず、また外観の良好な組成物を得られない。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、ポリフェニレンエーテルの優れた誘電特性を保持し、かつ硬化後において優れた耐薬品性と耐熱性を示す新規な硬化性樹脂組成物を提供しようとするものである。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明者らは上述のような課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、本発明の目的に沿った新規な樹脂組成物を見い出し本発明を完成するに至った。本発明は次に述べる5つの発明により構成される。すなわち本発明の第1は、(a) ポリフェニレンエーテルと不飽和カルボン酸または酸無水物との反応生成物、および、(b) ジアリルフタレート、ジビニ

ルベンゼン、多官能性アクリロイル化合物、多官能性メタクリロイル化合物、多官能性マレイミド、多官能性シアン酸エスチル、多官能性イソシアネート、不飽和ポリエスチル、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、架橋性ポリブタジエンポリマーからなる化合物群から選ばれた少なくとも1つの化合物および／またはそのプレポリマーからなる硬化性樹脂組成物、および、(c)熱可塑性樹脂であって、(a)成分と(b)成分と(c)成分の和100重量部を基準として(a)成分が98~40重量部、(b)成分が2~60重量部、(c)成分が2~60重量部であることを特徴とする硬化性樹脂組成物を提供する。

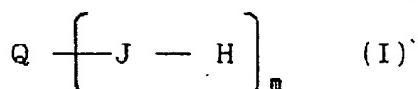
*

*【0007】本発明の第2は、上記第1発明の硬化性樹脂組成物を硬化して得られた硬化樹脂組成物を提供する。本発明の第3は、上記第1発明の硬化性樹脂組成物と基材からなる硬化性複合材料を提供する。本発明の第4は、上記第3発明の硬化性複合材料を硬化して得られた硬化複合材料を提供する。

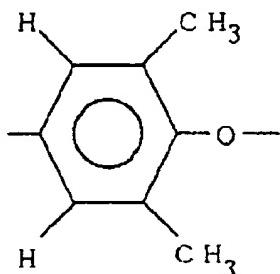
【0008】本発明の第5は、上記第4発明の硬化複合材料と金属箔からなる積層体を提供する。以下にこの発明を詳しく説明する。本発明において使用されるポリフェニレンエーテルは次の一般式化1で表される。

【0009】

【化1】



[式中、mは1~6の整数であり、Jは次式(I I)で表される単位から、実質的に構成されるポリフェニレンエーテル鎖であり



.....(II)

Qはmが1のときは水素原子を表し、mが2以上のときは一分子中に2~6個のフェノール性水酸基を持ち、フェノール水酸基のオルト位およびパラ位に重合不活性な置換基を有する多官能性フェノール化合物の残基を表す。]

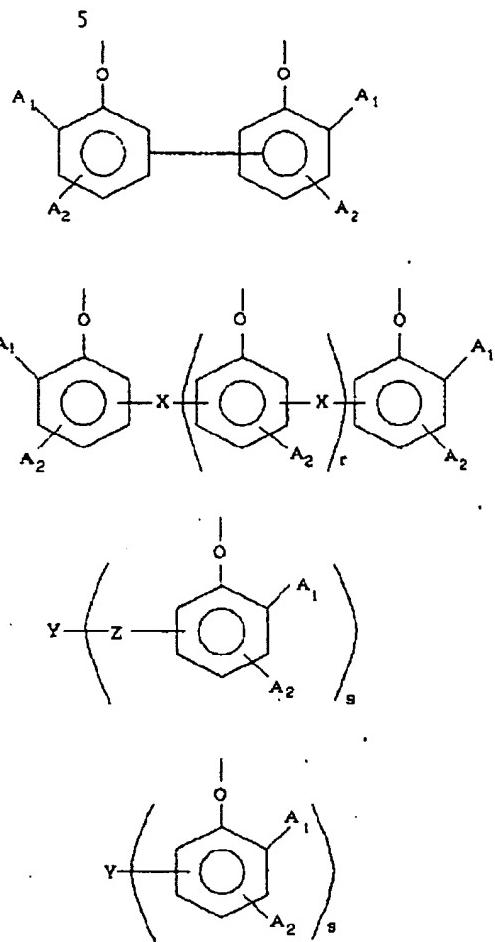
【0010】一般式AにおけるR₁~R₄の低級アルキル基の例としては、メチル基、エチル基、n-ブロビル基、イソブロビル基、n-ブチル基、イソブチル基等が挙げられる。アリール基の例としては、フェニル基等が挙げられる。ハロアルキル基の例としては、ブロモメチル基、クロロメチル基等が挙げられる。ハロゲン原子の

例としては臭素、塩素等が挙げられる。

【0011】化1のQの代表的な例としては、つきの4種の一般式化2で表される化合物群が挙げられる。

【0012】

【化2】



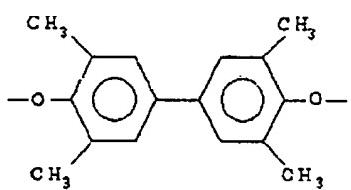
(式中、A₁、A₂は同一または異なる炭素数1～4の直鎖状アルキル基を表し、Xは脂肪族炭化水素残基およびそれらの置換誘導体、アラルキル基およびそれらの置換誘導体、酸素、硫黄、スルホニル基、カルボニル基を表し、Yは脂肪族炭化水素残基およびそれらの置換誘導体、芳香族炭化水素残基およびそれらの置換誘導体、アラルキル基およびそれらの置換誘導体を表し、Zは酸素、硫黄、スルホニル基、カルボニル基を表しA₂と直接結合した2つのフェニル基、A₂とX、A₂とY、A₂とZの結合位置はすべてフェノール性水酸基のオルト位およびパラ位を示し、rは0～4、Sは2～6の整数を表す。)

【0013】具体例として、下記化3～化4等が挙げられる。

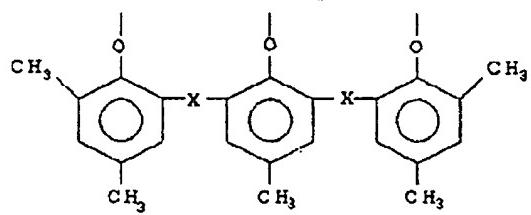
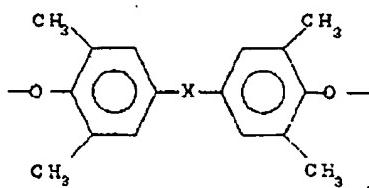
【0014】

【化3】

7



8



(但し X は、 $-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{C}(\text{CH}_3)-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{S}(\text{O})-$ 、 $-\text{C}(=\text{O})-$)

【0015】

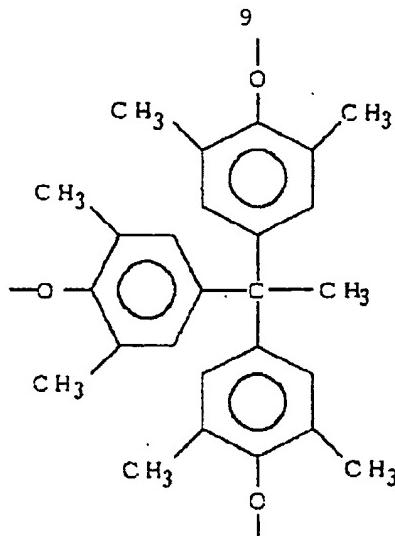
【化4】

10

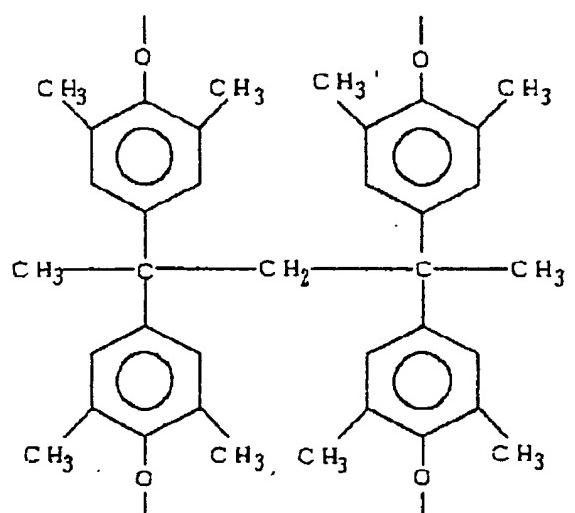
【0016】一般式化1中のJで表されるポリフェニレンエーテル鎖中には、一般式Aで表される単位の他、次の一般式化5で表される単位が含まれていてもよい。

【0017】

【化5】



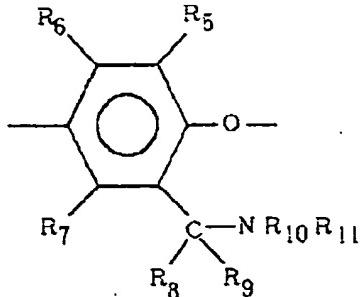
10



20

30

11

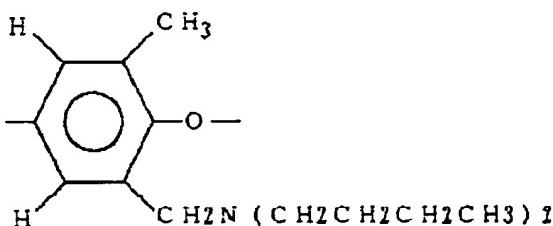


· · · · (B)

12

[式中、R₅～R₁₁は各々独立に水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、アリール基、ハロアルキル基を表し、R₁₀、R₁₁が同時に水素である事はない。]

一般式Bの単位の例としては、

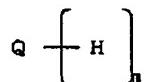


等が挙げられる。

【0018】本発明に用いられる一般式化1のポリフェニレンエーテル樹脂の好ましい例としては、2, 6-ジメチルフェノールの単独重合で得られるポリ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレンエーテル)、ポリ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレンエーテル)のスチレングラフト重合体、2, 6-ジメチルフェノールと2, 3, 6-トリメチルフェノールの共重合体、2, 6-ジメチルフェノールと2-メチル-6-フェニルフェノールの共重合体、2, 6-ジメチルフェノールと多官能フェノール化合物：一般式(6)、

【0019】

【化6】



【0020】の存在下で重合して得られた多官能性ポリフェニレンエーテル樹脂、例えば特開昭63-301222号公報、特開平1-297428号公報に開示されているような一般式AおよびBの単位を含む共重合体等が挙げられる。以上述べたポリフェニレンエーテル樹脂の分子量については、30°C、0.5 g/dlのクロロホルム溶液で測定した粘度数ηsp/cが0.1～1.0の範囲にあるものが良好に使用できる。溶融樹脂流れを重視する硬化性樹脂組成物、例えば多層配線板用プリプレグとしては、粘度数の小さい樹脂が好ましい。

【0021】本発明に用いられる(a)成分は、上記のポリフェニレンエーテル樹脂を不飽和カルボン酸または

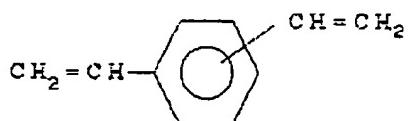
酸無水物と反応させることによって製造される。適当な酸および酸無水物の例としては、アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、無水イタコン酸、無水グルタコン酸、無水シトラコン酸等が挙げられる。特に無水マレイン酸、フマル酸が最も良好に使用できる。反応はポリフェニレンエーテル樹脂と不飽和カルボン酸または酸無水物を100°C～390°Cの温度範囲で加熱することによって行われる。この際ラジカル開始剤を共存させてもよい。溶液法と溶融混合法の両方が使用できるが、押出し機等を用いる溶融混合法の方が簡便に行うことができ、本発明の目的に適している。不飽和カルボン酸または酸無水物の割合は、ポリフェニレンエーテル樹脂100重量部に対し、0.01～5.0重量部、好ましくは0.1～3.0重量部である。

【0022】本発明の硬化性樹脂組成物の(b)成分としては、ジアリルフタレート、ジビニルベンゼン、多官能性アクリロイル化合物、多官能性メタクリロイル化合物、多官能性マレイミド、多官能性シアン酸エステル、多官能性イソシアネート、不飽和ポリエステルからなる化合物群から選ばれた少なくとも一つの化合物および/またはそのプレポリマーが用いられる。

【0023】本発明に用いられるジアリルフタレートおよびジビニルベンゼンとは、それぞれ次の構造式で表される化合物である。

【0024】

【化7】



【0025】これらの化合物は、オルト、メタ、パラの *れる物である。

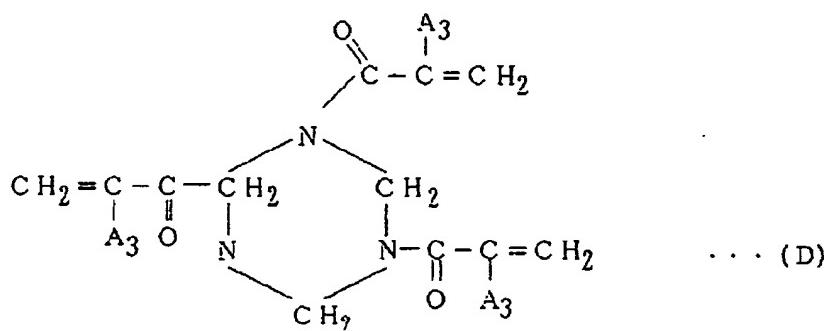
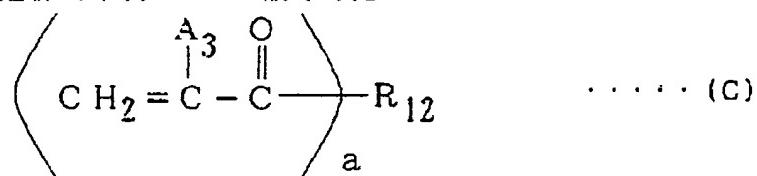
いずれの異性体も本発明に用いることができる。本発明

【0026】

に用いられる多官能性アクリロイル化合物および多官能

【化8】

性メタクリロイル化合物とは、次の2つの一般式で表さ*



【式中、aは2~10の整数であり、A₃は水素またはメチル基を表し、R₁₂は多価ヒドロキシ基含有有機化合物の残基を表す。】

【0027】一般式(C)の多官能性アクリロイルもしくはメタクリロイル化合物R₁₂の例としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、ヘキサンジオール、グリセリン、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ソルビトール、ビス(ヒドロキシメチル)シクロヘキサン、水素添加ビスフェノールAなどで例示されるアルカンポリオールの残基；ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコールポリプロピレングリコールなどで例示されるポリエーテルポリオールの

40 残基；キシレングリコール、ビスフェノールAで代表される複数個のベンゼン環が橋接部を介して連結された芳香族性ポリオールおよびこれらの芳香族ポリオールのアルキレンオキサイド付加物などで例示される芳香族ポリオール残基；フェノールとホルムアルデヒドとを反応させて得られるベンゼン多核体（通常、10核体以下のものが好適に用いられる）の残基；エボキシ基を2個以上有するエボキシ樹脂から導かれる残基；末端に水酸基を2個以上有するポリエステル樹脂から導かれる残基があり、具体的な化合物としては、エチレングリコールジアクリレート、ブロピレングリコールジアクリレート、

1, 3-プロパンジオールジアクリレート、1, 4-ブタンジオールジアクリレート、1, 3-ブタンジオールジアクリレート、1, 5-ベンタンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、1, 6-ヘキサンジオールジアクリレート、グリセリントリアクリレート、1, 1, 1-メチロールエタンジアクリレート、1, 1, 1-トリメチロールエタントリアクリレート、1, 1, 1-トリメチロールプロパンアクリレート、1, 1, 1-トリメチロールプロパントリアクリレート、ベンタエリスリトールジアクリレート、ベンタエリスリトールトリアクリレート、ベンタエリスリトールテトラアクリレート、ソルビトールテトラアクリレート、ソルビトールヘキサアクリレート、ソルビトールベニタアクリレート、1, 4-ヘキサンジオールジアクリレート、2, 2-ビス(アクリロキシシクロヘキサン)プロパン、ジエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレート、ビスフェノールA-ジアクリレート、2, 2-ビス(4-(2-アクリロキシエトキシ)フェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-(アクリロキシ-ジ-(エチレンオキシ)フェニル))プロパン、2, 2-ビス(4-*

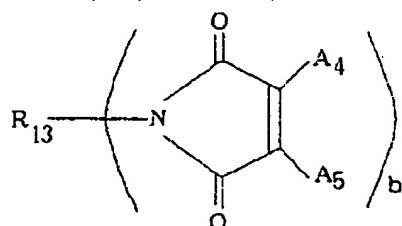
* (アクリロキシポリ-(エチレンオキシ)フェニル)プロパン；フェノール樹脂初期縮合体の多価アクリレート；ビスフェノールA系エボキシ樹脂、ノボラック系エボキシ樹脂、脂環式エボキシ樹脂、フタル酸ジグリジルエステルとポリカルボン酸等とアクリル酸とを反応させて得られるエボキシアクリレート類；末端に水酸基を2個以上有するポリエステルとアクリル酸とを反応して得られるポリエステルポリアクリレート類；上述したアクリレートがメタクリレート類になったもの；さらにはこれらの化合物の水素原子が例えば2, 2-ジブロモメチル-1, 3-プロパンジオールジメタクリレートのように一部ハロゲンで置換されたもの等が挙げられる。

【0028】一般式(D)の多官能性アクリロイルもしくはメタクリロイル化合物の代表的な例としては、ヘキサヒドロ-1, 3, 5-トリアクリロイル-s-トリアジン、ヘキサヒドロ-1, 3, 5-トリメタクリロイル-s-トリアジンが挙げられる。本発明に用いられる多官能性マレイミドとは、次の一般式で表されるものである。

【0029】

【化9】

... (E)



[式中、bは2~10の整数であり、A₄、A₅は水素、ハロゲンまたは低級アルキル基を表し、R₁₃は2~10価の芳香族または脂肪性有機基を表す。]

【0030】一般式(E)の多官能性マレイミドは、無水マレイン酸類と分子内にアミノ基を2~10個有するポリアミンとを反応させてマレアミド酸とし、ついでこのマレアミド酸を脱水環化することにより製造されるものである。好適なアミンとしては、メタフェニレンジアミン、バラフェニレンジアミン、メタキシリレンジアミン、バラキシリレンジアミン、1, 4-シクロヘキサンジアミン、ヘキサヒドロキシリレンジアミン、4, 4-ジアミノビフェニル、ビス(4-アミノフェニル)メタン、ビス(4-アミノフェニル)エーテル、ビス(4-アミノフェニル)スルホン、ビス(4-アミノ-3-メチルフェニル)メタン、ビス(4-アミノフェニル)シクロヘキサン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、2, 2-

-ビス(4-アミノ-3-メチルフェニル)プロパン、ビス(4-アミノ-3-クロロフェニル)メタン、2, 2-ビス(3, 5-ジブロモ-4-アミノフェニル)メタン、3, 4-ジアミノフェニル-4'-アミノフェニルメタン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-1-フェニルエタン、s-トリアジン環を持ったメラニン類、アニリンとホルムアルデヒドを反応させて得られるポリアミン(通常、ベンゼン核が10核体以下のものが好適に用いられる)等が挙げられる。

【0031】本発明に用いられる多官能性シアン酸エステルとは、次の一般式で表されるものである。

【0032】

【化10】

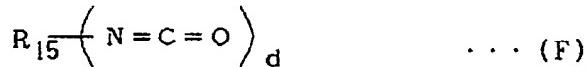
17



18

【式中、cは、2~10の整数であり、R₁₄は2~10価の芳香族性有機基を表し、シアノ酸エステル基は有機基R₁₄の芳香環に直接結合している。】

【0033】一般式(E)の多官能シアノ酸エステルの例としては、1, 3-ジシアネートベンゼン、1, 4-ジシアネートベンゼン、1, 3, 5-トリシアネートベンゼン、1, 3-ジシアネートナフタレン、1, 4-ジシアネートナフタレン、1, 6-ジシアネートナフタレン、1, 8-ジシアネートナフタレン、2, 6-ジシアネートナフタレン、2, 7-ジシアネートナフタレン、1, 3, 6-トリシアネートナフタレン、4, 4-ジシアネートビフェニル、ビス(4-シアネートフェニル)メタン、2, 2-ビス(4-シアネートフェニル)プロパン、2, 2-ビス(3, 5-ジシクロ-4-シアネートフェニル)プロパン、2, 2-ビス(3, 5-ジブロ)^{*20}



【式中、dは2~10の整数であり、R₁₅は2~10価の芳香族または脂肪族性有機基を表す。】

【0036】一般式(F)の多官能性イソシアネートの例としては、2, 4-トルエンジイソシアネート、2, 6-トルエンジイソシアネート、メタフェニレンジイソシアネート、パラフェニレンジイソシアネート、メタキシリレンジイソシアネート、1, 5-ナフタレンジイソシアネート、4, 4-ジフェニルメタンジイソシアネート、トリジンジイソシアネート、テトラメチルキシレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、シクロヘキサン-1, 4-ジイソシアネート、リジンイソシアネート、トリフェニルメタントリイソシアネート、トリス(イソシアネートフェニル)チオホスフェート、1, 6, 11-ウンデカントリイソシアネート、1, 8-ジイソシアネート-4-イソシアネートメチルオクタン、1, 3, 6-ヘキサメチレントリイソシアネート、ビシクロヘプタントリイソシアネート、ポリメチレンポリフェニルイソシアネート等が挙げられる。

【0037】これらの多官能性イソシアネートは、種々のブロック剤を用いて多官能性ブロックイソシアネートに変換して用いることもできる。ブロック剤の例としては、アルコール類、フェノール類、オキシム類、ラクタム、マロン酸エステル、アセト酢酸エステル、アセチルアセトン、アミド類、イミダゾール類、亜硫酸塩等公知

* モ-4-シアネートフェニル)プロパン、ビス(4-シアネートフェニル)エーテル、ビス(4-シアネートフェニル)チオエーテル、ビス(4-シアネートフェニル)スルホン、トリス(4-シアネートフェニル)ホスファイト、トリス(4-シアネートフェニル)ホスフェート、およびフェノール樹脂とハロゲン化シアノとの反応により得られるベンゼン多核体のポリシアネート化合物等が挙げられる。

【0034】本発明に用いられる多官能性イソシアネートとは、次の一般式で表されるものである。

【0035】

【化11】

のものが使用できる。

【0038】本発明に用いられる不飽和ポリエステルとは、グリコール類を不飽和多塩基酸および飽和多塩基酸、あるいはこれらの無水物、エステル、酸クロライドと反応させることによって得られるものであり、一般的のものが用いられる。グリコール類の代表的な例としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ジフロビレングリコール、ネオペンチルグリコール、1, 3-ブタンジオール、1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサンジオール、水素化ビスフェノールA、ビスフェノールAプロピレンオキシド付加物、ジブロモネオペントルグリコール等が挙げられる。

【0039】不飽和多塩基酸の代表的な例としては、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸等が挙げられる。飽和多塩基酸の代表的な例としては、無水フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、エンドメチレンテトラヒドロ無水フタル酸、アジピン酸、セバシン酸、テット酸、テラブロモ無水フタル酸等が挙げられる。

【0040】不飽和ポリエステルの詳細については、例えば滝山榮一郎著、「ポリエステル樹脂ハンドブック」

(日刊工業新聞社、1988)を参照のこと。本発明の硬化性樹脂組成物の(b)成分としては、以上述べた化合物群のうちから1種のみを、あるいは2種以上組み合わせて用いることができる。またこれらの化合物を、後述する公知の触媒、開始剤、硬化剤等の存在下または不存在下で熱、光等により予備反応せしめて得られるプレポリマーも本発明の(b)成分として用いることができる。

【0041】本発明の硬化性樹脂組成物の(c)成分として用いられる熱可塑性樹脂とは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、エチレン・ブロビレン共重合体、ポリ(4-メチル-1-ベンゼン)等のポリオレフィン類およびその誘導体、ナイロン4、ナイロン6、ナイロン6·6、ナイロン6·10、ナイロン12などのポリアミド類及びその誘導体、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポチエチレンナフタレート、ポリエチレンテレフタレート・ポリエチレンリコールブロック共重合体などのポリエステル類およびその誘導体、ポリフェニレンエーテル、ポリカーボネート、ポリアセタール、ポリスルファン、ポリ塩化ビニルおよびその共重合体、ポリ塩化ビニリデンおよびその共重合体、ポリメチルメタクリレート類、アクリル酸(またはメタクリル酸)エステル共重合体類、ポリスチレン類、アクリロニトリルスチレン共重合体、アクリロニトリルスチレンブタジエン系共重合体等のポリスチレン類およびその共重合体類、ポリ酢酸ビニル類、ポリビニルホルマール、ポリビニルアセタール、ポリビニルブチラール類、エチレン酢酸ビニル共重合体およびその加水分解物類、ポリビニルアルコール類、スチレンブタジエンブロック共重合体類、ポリブタジエン、ポリイソブレン類のゴム類、ポリメトキシエチレン、ポリエトキシエチレン等のポリビニルエーテル類、ポリアクリルアマイド、ポリホスファーゼン類、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポリフェニレンサルファイト、ポリアミドイミド、熱可塑性ポリイミド、芳香族ポリエステル等の液晶ポリマー、側鎖に液晶成分を含有する側鎖型液晶ポリマー等が挙げられる。

【0042】以上の(a)、(b)、(c)成分の配合比は広範囲に変化させることができるが、本発明においては(a)、(b)成分両者の合計100重量部を基準にして、(a)成分を98~40重量部、(b)成分を2~60重量部、より好ましくは(a)成分を95~50重量部、(b)成分を5~50重量部とするのがよい。(b)成分が2重量部未満では耐薬品性の改善が不十分であり好ましくない。逆に60重量部を越えると誘電特性が低下するので好ましくない。また、本発明において、(c)成分の配合比は(a)+(b)成分100重量部に対して2~60重量部、より好ましくは5~50重量部とするのがよい。(c)成分が2重量部未満では成膜性の改善が不十分であり、好ましくない。逆に6

0重量部を越えると耐薬品性が低下するので好ましくない。

【0043】本発明の硬化性樹脂組成物には、機械的強度を高め、寸法安定性を増大させるために基材を加えることができる。本発明に用いられる基材としては、ローピングクロス、クロス、ショップドマット、サーフェシングマットなどの各種ガラス布、アスペスト布、金属繊維布およびその他合成もしくは天然の無機繊維布；ポリビニルアルコール繊維、ポリエステル繊維、アクリル繊維、全芳香族ポリアミド繊維、ポリテトラフルオロエチレン繊維などの合成繊維から得られる織布または不織布；綿布、麻布、フェルトなどの天然繊維布；カーボン繊維布；クラフト紙、コットン紙、紙一ガラス混織紙などの天然セルロース系布などがそれ単独で、あるいは2種以上併せて用いられる。

【0044】本発明の硬化性複合材料における基材の占める割合は、硬化性複合材料100重量部を基準として5~90重量%、より好ましくは10~80重量%さらに好ましくは20~70重量%である。基材が5重量%より少なくなると複合材料の硬化後の寸法安定性や強度が不十分であり、また基材が90重量%より多くなると複合材料の誘電特性や難燃性が劣り好ましくない。

【0045】本発明で用いられる金属箔としては、例えば銅箔、アルミニウム箔等が挙げられる。その厚みは特に限定されないが、5~200μm、より好ましくは5~105μmの範囲である。上記の(a)、(b)、(c)成分を混合する方法としては、3者を溶媒中に均一に溶解または分散させる溶液混合法、あるいは押し出し機等により加熱して行う溶融ブレンド法等が利用できる。溶液混合に用いられる溶媒としては、ジクロロメタン、クロロホルム、トリクロロエチレンなどのハロゲン系溶媒；ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族系溶媒；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン系溶媒；テトラヒドロフランが単独あるいは二種以上を組み合わせて用いられる。

【0046】本発明の硬化性樹脂組成物は、あらかじめその用途に応じて成形、硬化させてよい。成形方法は特に限定されない。通常は、樹脂組成物を上述した溶媒に溶解させ好みの形に成形するキャスト法、または樹脂組成物を加熱溶融し好みの形に成形する加熱溶融法が用いられる。上述したキャスト法と加熱溶融法は単独で行ってよい。またそれを組み合わせて行ってよい。例えば、キャスト法で作成された本発明の硬化性樹脂組成物のフィルムを数~数十枚積層し、加熱溶融法、例えばプレス成形機で加熱溶融し、本樹脂組成物のシートを得ることができる。

【0047】本発明の硬化性複合材料を製造する方法としては、例えば本発明の(a)、(b)、(c)成分と必要に応じて他の成分を前述のハロゲン系、芳香族系、ケトン系等の溶媒もしくはその混合溶媒中に均一に溶解

または分散させ、基材に含浸させた後乾燥する方法が挙げられる。含浸は浸漬（ディッピング）、塗布等によって行われる。含浸は必要に応じて複数回繰り返すことも可能であり、またこの際組成や濃度の異なる複数の溶液を用いて含浸を繰り返し、最終的に希望とする樹脂組成および樹脂量に調整することも可能である。

【0048】本発明の硬化性複合材料には、必要に応じて樹脂と基材の界面における接着性を改善する目的でカップリング剤を用いることができる。カップリング剤としては、シランカップリング剤、チタネートカップリング剤、アルミニウム系カップリング剤、ジルコアルミネートカップリング剤等一般のものが使用できる。本発明の樹脂組成物は後述するように加熱等の手段により架橋反応を起こして硬化するが、その際の反応温度を低くしたり不飽和基の架橋反応を促進する目的でラジカル開始剤を含有させて使用してもよい。

【0049】本発明の硬化性樹脂組成物に用いられるラジカル開始剤の量は（a）成分と（b）成分の和を基準として0.1～10重量%、好ましくは0.1～8重量%である。ラジカル開始剤の代表的な例を挙げると、ベンゾイルバーオキサイド、クメンハイドロバーオキサイド、2,5-ジメチルヘキサン-2,5-ジハイドロバーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ（t-ブチルバーオキシ）ヘキシン-3、ジ-t-ブチルバーオキサイド、t-ブチルクミルバーオキサイド、 α 、 α' -ビス（t-ブチルバーオキシ-m-イソプロピル）ベンゼン、2,5-ジメチル-2,5-ジ（t-ブチルバーオキシ）ヘキサン、ジクミルバーオキサイド、ジ-t-ブチルバーオキシソフタレート、t-ブチルバーオキシベンゾエート、2,2-ビス（t-ブチルバーオキシ）ブタン、2,2-ビス（t-ブチルバーオキシ）オクタン、2,5-ジメチル-2,5-ジ（ベンゾイルバーオキシ）ヘキサン、ジ（トリメチルシリル）バーオキサイド、トリメチルシリルトリフェニルシリルバーオキサイド等の過酸化物があるがこれらに限定されない。また過酸化物ではないが、2,3-ジメチル-2,3-ジフェニルブタンもラジカル開始剤として使用できる。しかし、本樹脂組成物の硬化に用いられる開始剤はこれらの例に限定されない。

【0050】この他、多官能性マレイミドの適した硬化剤としてはポリアミンが、多官能性シアン酸エステルに適した触媒としては鉛酸、ルイス酸、炭酸ナトリウムあるいは塩化リチウム等の塩類、トリブチルホスフィン等のリン酸エステル類等が、また多官能性イソシアネートに適した触媒、硬化剤としては、例えば岩田敬治編、「ポリウレタン樹脂ハンドブック」（日刊工業新聞社、1987）118～123頁中に教示されているようなアミン類、有機金属、多価アルコール等がそれぞれ挙げられる。

【0051】以上の触媒、開始剤、硬化剤等は、（b）

成分の種類に応じて適宜選択して用いられる。本発明の樹脂組成物は、その用途に応じて所望の性能を付与させる目的で本来の性質を損なわない範囲の量の充填剤や添加剤を配合して用いることができる。充填剤は纖維状であっても粉末状であってもよく、カーボンブラック、シリカ、アルミナ、タルク、雲母、ガラスピース、ガラス中空球等を挙げることができる。添加剤としては、酸化防止剤、熱安定剤、帯電防止剤、可塑剤、顔料、染料、着色剤等が挙げられる。また難燃性の一層の向上を図る目的で塩素系、臭素系、リン系の難燃剤や、Sb₂O₃、Sb₂O₅、Nb₂SbO₅・1/4H₂O等の難燃助剤を併用することもできる。基材を含む複合材料では、臭素化ジフェニルエーテルと酸化アンチモンの組み合わせが好ましく用いられる。

【0052】さらには、本発明の硬化性樹脂組成物にはこの他スチレン、ビニルトルエン、 α -メチルスチレン、メタクリル酸メチル、アクリル酸メチル、酢酸ビニル、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレート、アリルグリシジルエーテル、メタクリル酸グリシジル、アクリル酸グリシジルなどの架橋性のモノマー、ポリフェニレンエーテルをはじめとする熱可塑性樹脂、あるいはエポキシ樹脂、フェノール樹脂等の熱硬化性樹脂を一種または二種以上配合することが可能である。

【0053】本発明の硬化樹脂組成物は、以上に述べた硬化性樹脂硬化物を硬化することにより得られるものである。硬化の方法は任意であり、熱、光、電子線等による方法を採用することができる。加熱により硬化を行う場合その温度は、ラジカル開始剤、硬化剤の有無やその種類によっても異なるが、80～300℃、より好ましくは120～250℃の範囲で選ばれる。また時間は、1分～10時間程度、より好ましくは1分～5時間である。

【0054】得られた硬化樹脂組成物は、赤外吸収スペクトル法、高分解能固体核磁気共鳴スペクトル法、熱分解ガスクロマトグラフィー等の方法を用いて樹脂組成を解析することができる。本発明の硬化複合材料はフィルム状、あるいは少なくとも1種類の金属箔と、少なくとも片面に上述の金属箔を張り合わせた硬化樹脂組成物から構成される積層体として使用されることが可能である。

【0055】本発明の硬化複合材料は、このようにして得た硬化性複合材料を加熱等の方法により硬化することによって得られるものである。その製造方法は特に限定されるものではなく、例えば該硬化性複合材料を複数枚重ね合わせ、加熱加圧下に各層間を接着せしめると同時に熱硬化を行い、所望の厚みの硬化複合材料を得ることができる。また一度接着硬化させた硬化複合材料と硬化性複合材料を組み合わせて新たな層構成の硬化複合材料を得ることも可能である。積層成形と硬化は、通常熱プレス等を用い同時に行われるが、両者をそれぞれ単独で

行ってもよい。すなわち、あらかじめ積層成形して得た未硬化あるいは半硬化の複合材料を、熱処理または別 の方法で処理することによって硬化させることができる。

【0056】成形および硬化は、温度80～300°C、圧力0.1～1000kg/cm²、時間1分～10時間の範囲、より好ましくは、温度120～250°C、圧力1～100kg/cm²、時間1分～5時間の範囲で行うことができる。本発明の積層体とは、本発明の硬化複合材料と金属箔より構成されるものである。

【0057】本発明の積層体を製造する方法としては、例えば本発明の硬化性複合材料と、金属箔を目的に応じた層構成で積層し、加熱加圧下に各層間を接着せしめると同時に熱硬化させる方法を挙げることができる。積層体においては、硬化性複合材料と金属箔が任意の層構成で積層される。金属箔は表層としても中間層としても用いることができる。

【0058】また本発明の硬化性複合材料と金属板より構成される積層板および、金属箔、硬化複合材料、および金属板より構成される金属張り積層板も製造できる。積層板においては、金属板をベースとしその片面または両面に硬化性複合材料が積層される。金属張り積層板においては、金属板をベースとしその片面または両面に硬化性複合材料を介して金属箔が積層される。この際金属箔は最表層として用いられるが、最表層以外に中間層として用いてもよい。

【0059】上記の他、積層と硬化を複数回繰り返して多層化することも可能である。金属箔および金属板の接着には接着剤を用いることもできる。接着剤としては、エポキシ系、アクリル系、フェノール系、シアノアクリレート系等が挙げられるが、特にこれらに限定されない。上記の積層成形と硬化は、本発明の硬化複合材料と同様の条件で行うことができる。

【0060】

【実施例】以下、本発明を一層明確にするために実施例を挙げて説明するが、本発明の範囲をこれらの実施例に限定するものではない。

【0061】

【参考例1】30°C、0.5g/dlのクロロホルム溶液で測定した粘度数ηsp/cが0.54のポリ(2,6-ジメチル-1,4-フェニレンエーテル)100重量部と、無水マレイン酸1.5重量部、および2,5-ジメチル-2,5-ジ(タブチルバーオキシ)ヘキサン(日本油脂(株)製 バーエキサ25B)1.0重量部を室温でドライブレンドした後、シリンダー温度300°C、スクリュー回転数230rpmの条件で2軸押し出し機により押出した。この反応生成物をAとする。

【0062】

【参考例2】参考例1と同様の方法で測定した粘度数ηsp/cが0.60のポリ(2,6-ジメチル-1,4-フェニレンエーテル)100重量部と、無水マレイン酸1.5重量部を室温でドライブレンドした後、シリンダー温度300°C、スクリュー回転数230rpmの条件で2軸押し出し機により押出した。この反応生成物をBとする。

【0063】

【実施例1～3】

硬化性樹脂組成物および硬化樹脂組成物

A、またはBと各種化合物を表1に示した組成でヘンシェルミキサーを用いて混合し、プレス成形機により200°C、2時間の条件で成形・硬化させ、厚み約1mmの硬化物を作成した。

【0064】この硬化物は、トリクロロエチレン中で5分間煮沸しても反りおよび外観の変化は、認められず寸法安定性は良好であった。

【0065】

【表1】

	組成(重量部)			硬化条件			耐トリクロロエチレン 注2)
	AまたはB	硬化性化合物	熱可塑性 化合物	開始剤	温度 (°C)	時間 (hr)	
実施例1	80(A)	20(オルトジアリルフタレート)	20(a)	3(c)	200	2	○
実施例2	80(A)	20(オルトジアリルフタレート)	5(b)	3(c)	200	2	○
実施例3	60(B)	40(トリメチロールプロパン トリメタクリレート)	30(a)	5(c)	200	2	○
実施例4	85(A)	15(パラジビニルベンゼン)	30(a)	3(c)	200	2	○
実施例5	50(A)	50(不飽和ポリエスチル)	30(a)	3(d)	200	1	○
実施例6	80(B)	20(ケルイミド601)	30(a)	3(c)	200	2	○
実施例7	50(A)	50(4,4'-ジフェニルメタン ジイソジアネート)	30(a)	0.1(e) 3(c)	200	1	○
比較例1	60(-)	40(トリメチロールプロパン トリメタクリレート)	30(a)	5(c)	200	2	×
比較例2	80(A)	20(オルトジアリルフタレート)	0	3(c)	— 注3)	—	—

【0066】なお、表1中 注1) a : ポリスチレン

b : ポリカーボネート

c : 2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルバーオ

キシ)ヘキシン-3

d : t-ブチルバーオキシベンゾエート

e : ジブチル錫ラウレート

注2) ○ : 外観は良好であった。

【0067】× : 膨潤、反りが認められた。

注3) 成膜できなかった。

50 【0068】

【実施例4～7】

硬化性樹脂組成物からなるフィルムおよび硬化して得られたフィルム

A、またはBと各種化合物を表1に示した組成でクロロホルムに溶解した。この溶液をテフロンシャーレにキャストし、フィルムを得た。得られたフィルムは約100μmの厚みでありフィルムはべたつき等がなく成膜性に優れていた。

【0069】エアーオーブンで乾燥後、得られたフィルムを真空プレス成形機にて積層硬化して厚さ1mmの硬化物を作成した。この硬化物は、トリクロロエチレンで5分間煮沸しても反りおよび外観の変化は、認められず寸法安定性は良好であった。

【0070】

【比較例1】A、またはBの代わりにポリ(2,6-ジメチル-1,4-フェニレンエーテル) ($\eta_{sp}/c = 0.56$) を用いて、表1の組成で実施例1～3と同じ

10

操作を繰り返した。得られた硬化物をトリクロロエチレン中で5分間煮沸したところ、膨潤と反りが認められた。

【0071】

【比較例2】表1に示した組成で同じ操作を行ったところ、成膜性が悪いためひび割れが多く、フィルムが得られなかった。

【0072】

【実施例8～12】

硬化性複合材料

表2に示した組成で各成分をトリクロロエチレン中に溶解または分散させた。この溶液にガラスクロスを浸漬して含浸を行い、エアーオーブン中で乾燥させた。表面が平滑で外観が良好なプリブレグが得られた。

【0073】

【表2】

		組成(重量部)			基材 種類	重量 %
	AまたはB	硬化性化合物	熱可塑性化合物	触媒、開始剤		
実施例 8	A (85)	1.5 (パラジビニルベンゼン)	20 (a)	3 (e)	Eガラスクロス	35
実施例 9	A (85)	1.5 (パラジビニルベンゼン)	5 (b)	3 (e)	Eガラスクロス	35
実施例 10	A (85)	1.5 (パラジビニルベンゼン)	5 (c)	3 (e)	Eガラスクロス	35
実施例 11	A (85)	1.5 (パラジビニルベンゼン)	5 (d)	3 (e)	Eガラスクロス	35
実施例 12	B (60)	4.0 (オルトジアリルフタレート プレポリマー)	30 (a)	5 (e)	Eガラスクロス	45
実施例 13	A (60)	4.0 (パラジアリルアクリレート)	30 (a)	5 (e)	Dガラスクロス	50
実施例 14	A (60)	4.0 (BT2100)	90 (a)	0. 1 (f)、4 (g)	Eガラスクロス	35
実施例 15	B (30)	7.0 (BT2170)	30 (a)	0. 1 (f)、4 (g)	Eガラスクロス	45
実施例 16	A (70)	3.0 (トリメチロールプロパン トリアクリレート)	30 (a)	4 (g)	Dガラスクロス	50
比較例 3	- (85)	1.5 (パラジビニルベンゼン)	20 (a)	3 (e)	Eガラスクロス	35
比較例 4	- (60)	4.0 (BT2100)	30 (a)	0. 1 (f)、4 (g)	Eガラスクロス	35

〔0074〕なお、表2中 注1) a : ポリスチレン

b : ポリカーボネート

c : ナイロン66

d : ポリエチレンテレフタレート

e : 2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(t-ブチルバーオ

キシ)ヘキシン-3

f : オクチル酸亜鉛

g : ジクミルバーオキサイド

注2) BT2100, BT2170 : ビスマレイミド・

トリアジン樹脂

積層体

50 成形後の厚みが約0.8 mmになるように上記の硬化性

複合材料を複数枚重ね合わせ、その両面に厚さ $35\mu\text{m}$ の銅箔を置いてプレス成形機により成形硬化させて積層体を得た。各実施例の硬化条件を表3に示した。圧力は*

* いずれも $40\text{kg}/\text{cm}^2$ とした。

【0075】

【表3】

硬化時間 (hr)	温度 (°C)	耐トリクロロエチレン性		誘電率	誘電正接	ハシダ 耐熱性	銅箔引き剥し強さ (kg/cm)
		注1)					
実施例8	200	0.5	○	3.0	0.003	○	1.6
実施例9	200	0.5	○	2.8	0.003	○	1.6
実施例10	180	2	○	3.2	0.004	○	1.9
実施例11	180	2	○	3.5	0.005	○	2.0
実施例12	180	0.5	○	2.9	0.004	○	1.8
実施例13	180	0.5	○	2.9	0.004	○	1.8
実施例14	180	0.5	○	2.9	0.004	○	1.8
実施例15	180	0.5	○	2.9	0.004	○	1.8
実施例16	180	0.5	○	2.9	0.004	○	1.8
比較例3	200	0.5	×	2.8	0.003	×	1.4
比較例4	180	2	×	3.3	0.005	×	1.7

【0076】なお、表3中 注1) ○: 外観は良好であった。

×: 表面が白化し、ガラスクロスの露出が認められた。このようにして得られた積層体の諸物性を以下の方法で測定した。

1. 耐トリクロロエチレン性

銅箔を除去した積層体を 25mm 角に切り出し、トリクロロエチレン中で5分間煮沸し、外観の変化を目視により観察した (J I S C 6481に準拠)。

2. 誘電率、誘電正接

1MHz で測定を行った (J I S C 6481に準拠)。

3. ハンダ耐熱性

銅箔を除去した積層体を25mm角に切り出し、260°Cのハンダ浴中に120秒間浮かべ、外観の変化を目視により観察した（JIS C 6481に準拠）。

4. 銅箔引き剥し強さ

積層体から幅20mm、長さ100mmの試験片を切り出し、銅箔面に幅10mmの平行な切り込みを入れた後、面に対して垂直なる方向に50mm/分の速さで連続的に銅箔を引き剥し、その時の応力を引張り試験機にて測定し、その応力の最低値を示した（JIS C 6 10 481に準拠）。

【0077】

【比較例3、4】実施例7および10において、A、またはBの代わりに $\eta_{sp}/c = 0.56$ のポリ(2,6-ジメチル-1,4-フェニレンエーテル)を用いて同様の操作を行い、積層板を作製した。この積層板の耐トリクロロエチレン性を測定したところ、表面の著しい白化とガラスクロスの露出が認められた。

【0078】

【発明の効果】本発明の硬化性樹脂組成物は、溶媒成膜性が良好であり、表面のべたつき等がない取扱い性に優れたフィルムや硬化性複合材料が得られる。本発明の硬化性樹脂組成物を用いて得られる積層体、積層板、金属張り積層板は、良好な耐薬品性と優れた誘電特性を兼ね備えた材料である。

【0079】この他、耐熱性、金属との接着性、寸法安定性、あるいは熱放散性等の諸物性においてバランスのとれた特性を示す。従って本発明の材料は、電気産業、電子産業、宇宙・航空機産業等の分野において誘電材料、絶縁材料、耐熱材料等として用いることができる。特に片面、両面、多層プリント基板、セミリジット基板、金属ベース基板、多層プリント基板用ブリブルグとして好適に用いられる。

【0080】また本発明の材料は、その耐熱耐吸湿絶縁性の故に線間100μm以下の高密度回路基板、相間絶縁層の厚み200μm以下の多層回路基板、実装用回路基板用の接着剤として良好に使用できる。

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成13年2月13日(2001.2.13)

【公開番号】特開平6-179734

【公開日】平成6年6月28日(1994.6.28)

【年通号数】公開特許公報6-1798

【出願番号】特願平4-333918

【国際特許分類第7版】

C08F 299/02 MRS

2/44 MCS

C08L 71/12 LQP

【F I】

C08F 299/02 MRS

2/44 MCS

C08L 71/12 LQP

【手続補正書】

【提出日】平成11年11月25日(1999.11.25)

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書

【発明の名称】硬化性樹脂組成物